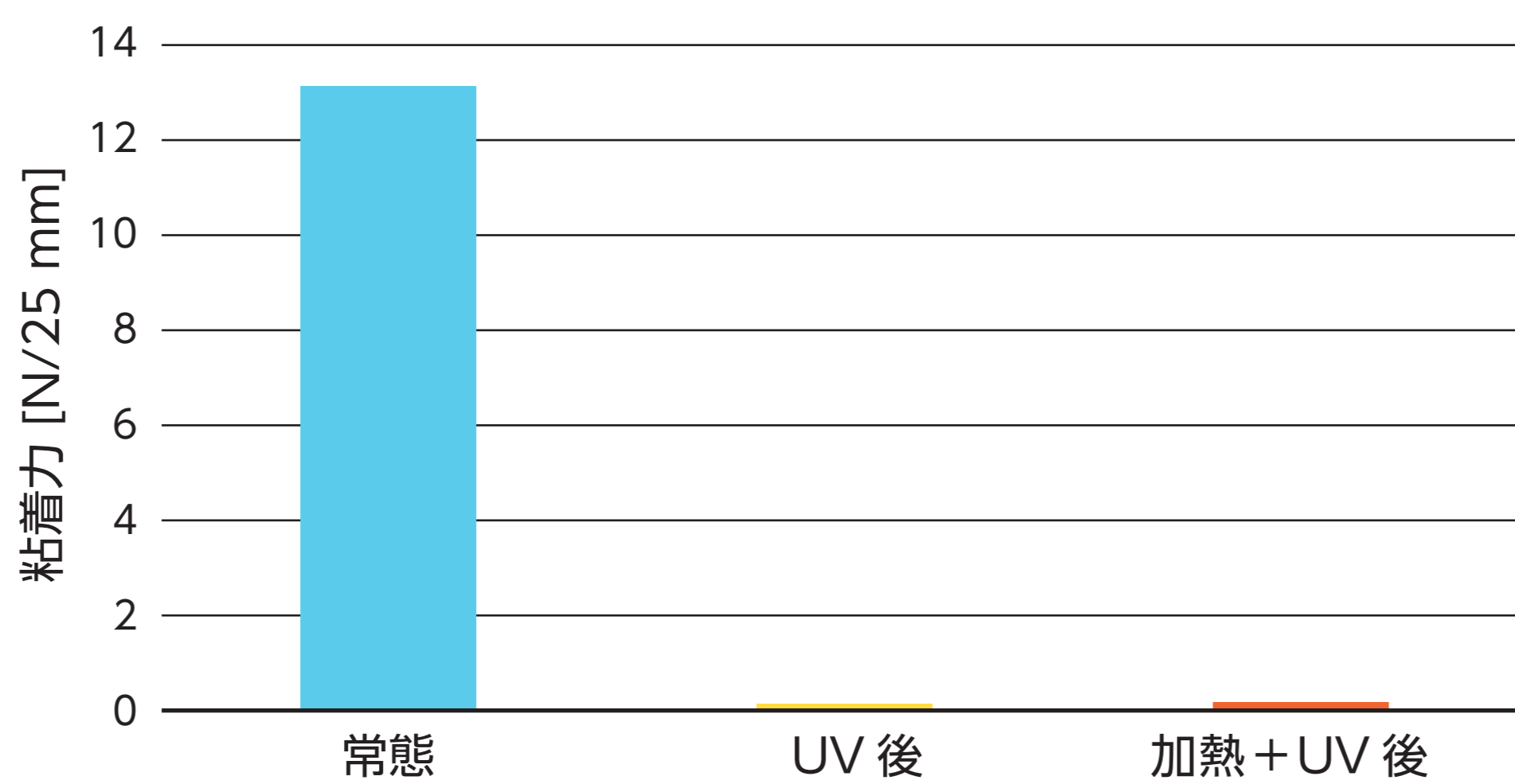
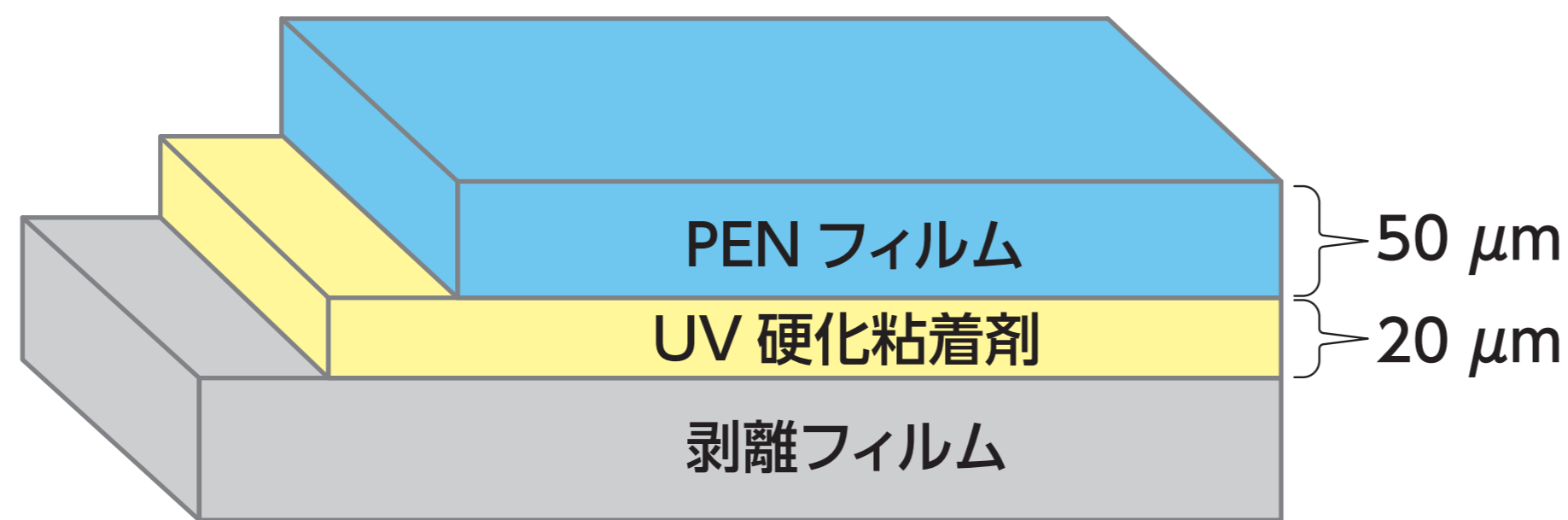


# 耐熱性ダイシングシート

半導体製造工程で使用可能な耐熱性に優れた UV 硬化タイプのダイシングシートです

## PEN タイプ

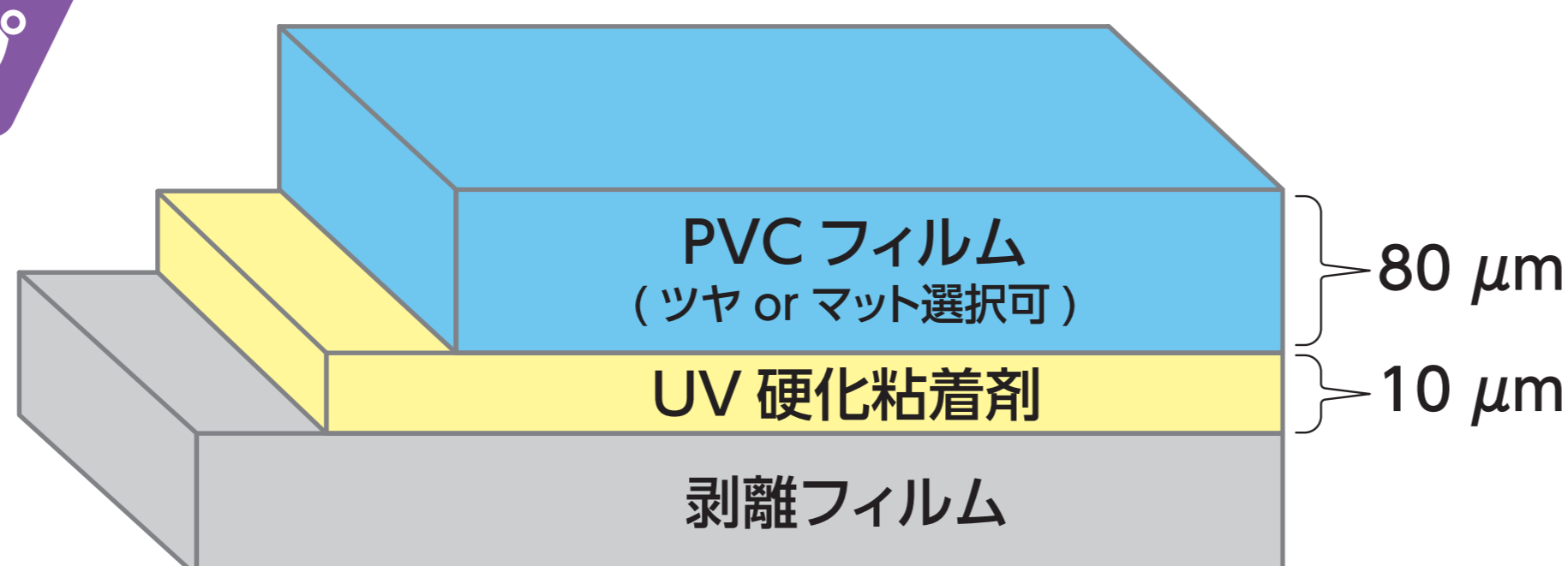


	粘着力 [N/25 mm]
常態	13.0
UV 後	0.06
加熱 + UV 後	0.10

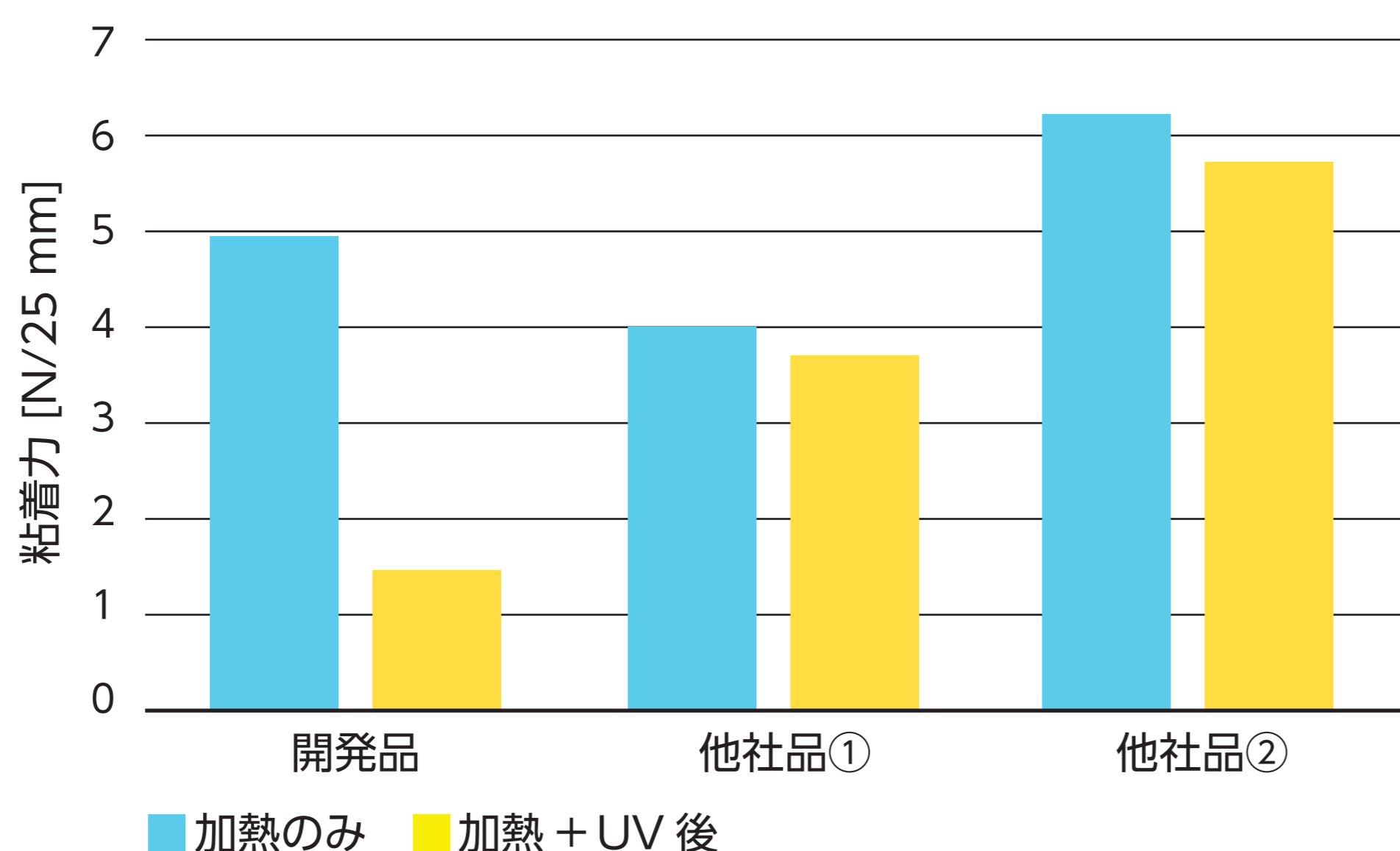
※各物性は代表値であり保証値ではありません

260℃×1分加熱しても、  
加熱なしと同じ程度まで  
UV 後の粘着力が低下します

## PVC タイプ



【120℃×1時間後における粘着力】



	粘着力 [N/25 mm]	
	加熱のみ	加熱 + UV 後
開発品	4.9	1.5
他社品①	4.0	3.8
他社品②	6.1	5.6

※各物性は代表値であり保証値ではありません

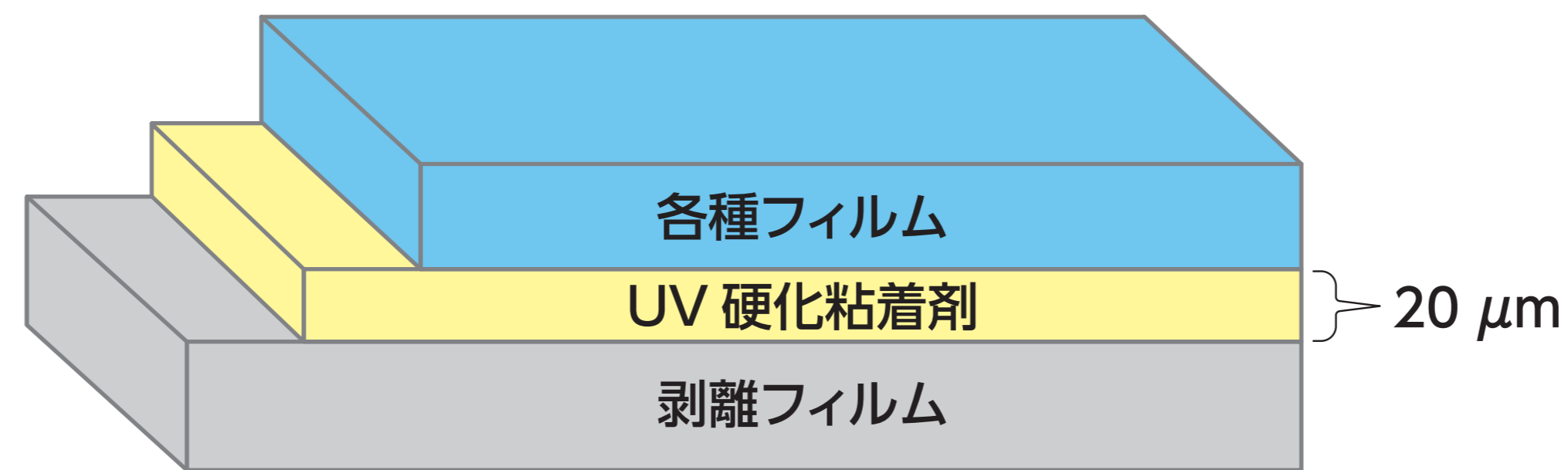
※開発品の追加物性  
加熱前の粘着力 [N/25mm]= 常態 : 3.7, UV 後 : 0.2  
破断強度 [N/10mm]=29.6 伸び率 [%]=340

120℃で 1 時間加熱しても  
UV 硬化機能が衰えず、  
他社品と比べて高い耐熱性を  
有しています

# UV-LED 対応 ダイシングシート

LED タイプ (波長 365nm) の UV 照射装置に対応した半導体工程用テープです

## 構成



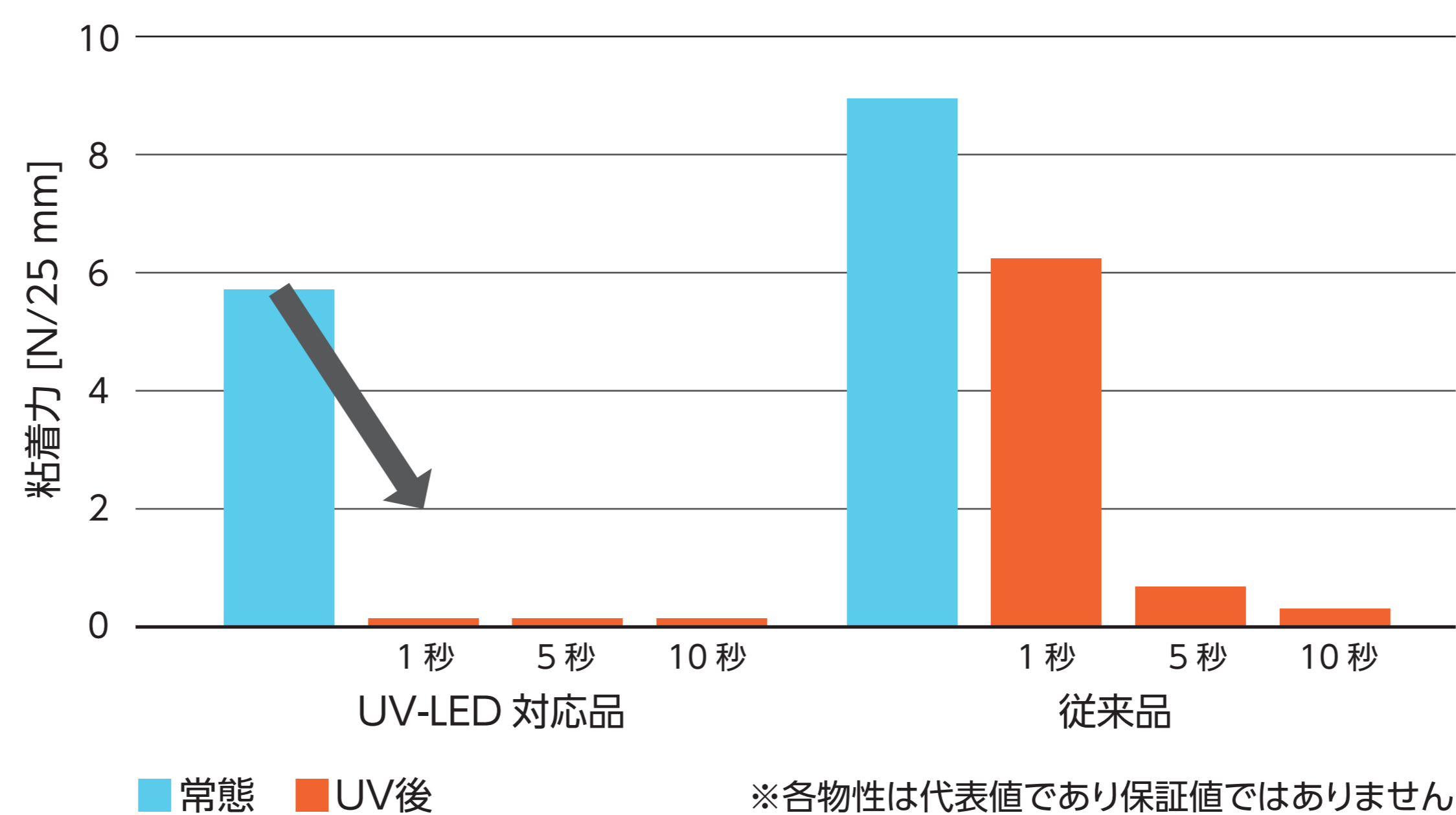
## 特長

- コスト面**  
 LED による長寿命化や消費電力の大幅な削減により、**生産コストを低減**可能です
- 品質面**  
 赤外線の影響がなく、熱ダメージを低減できることから、**製品品質が向上**します
- 製造面**  
 即時点灯により作業効率が向上、  
 オゾンレスで排気設備が必要ないことから、**生産環境の改善**につながります



UV-LED 照射装置

## 基本物性

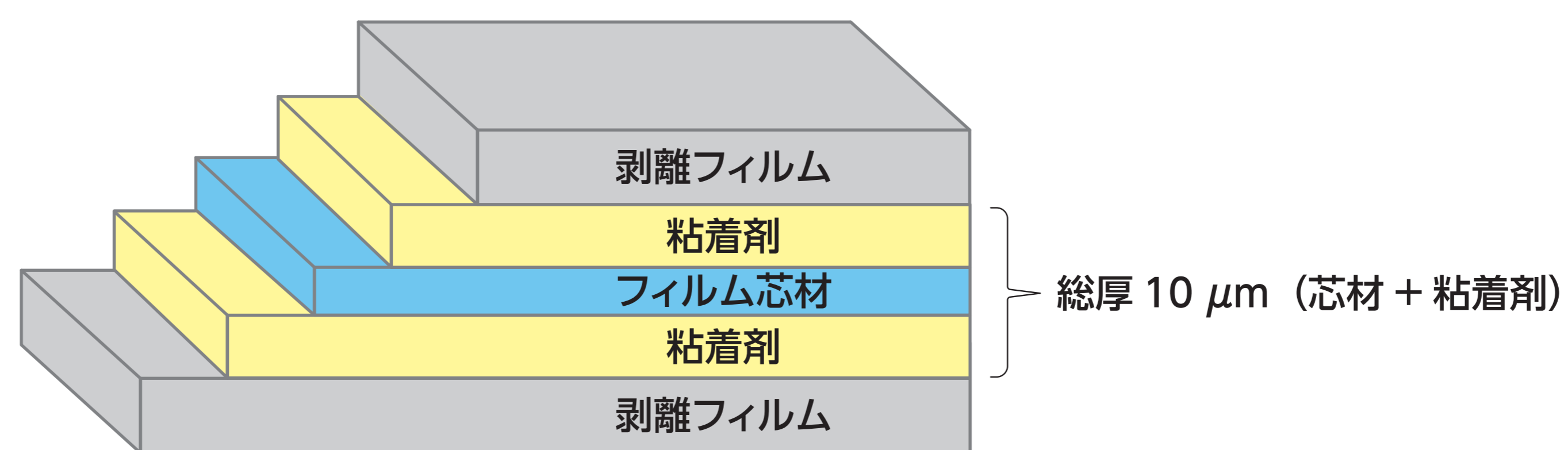


短時間の照射で粘着力が低下します

# 超薄膜両面テープ

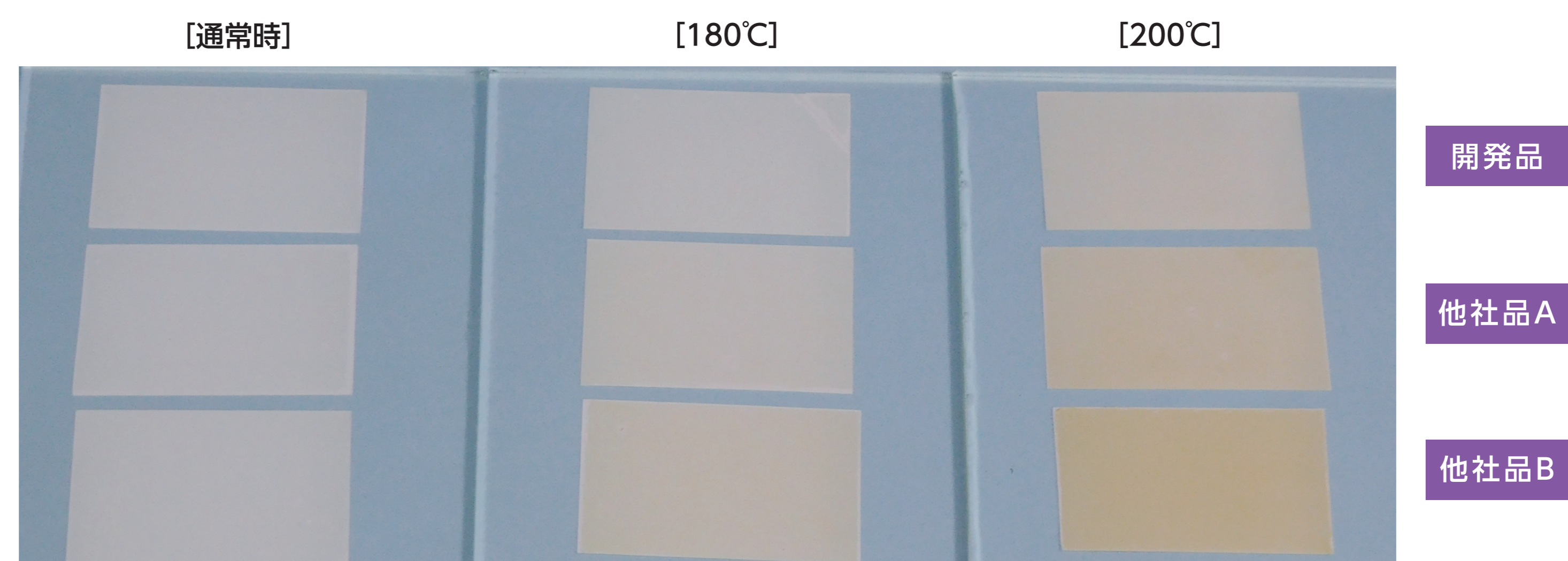
芯材と粘着剤を合わせた総厚が  $10\mu\text{m}$  の電子部材向け超薄膜両面テープです

## 構成

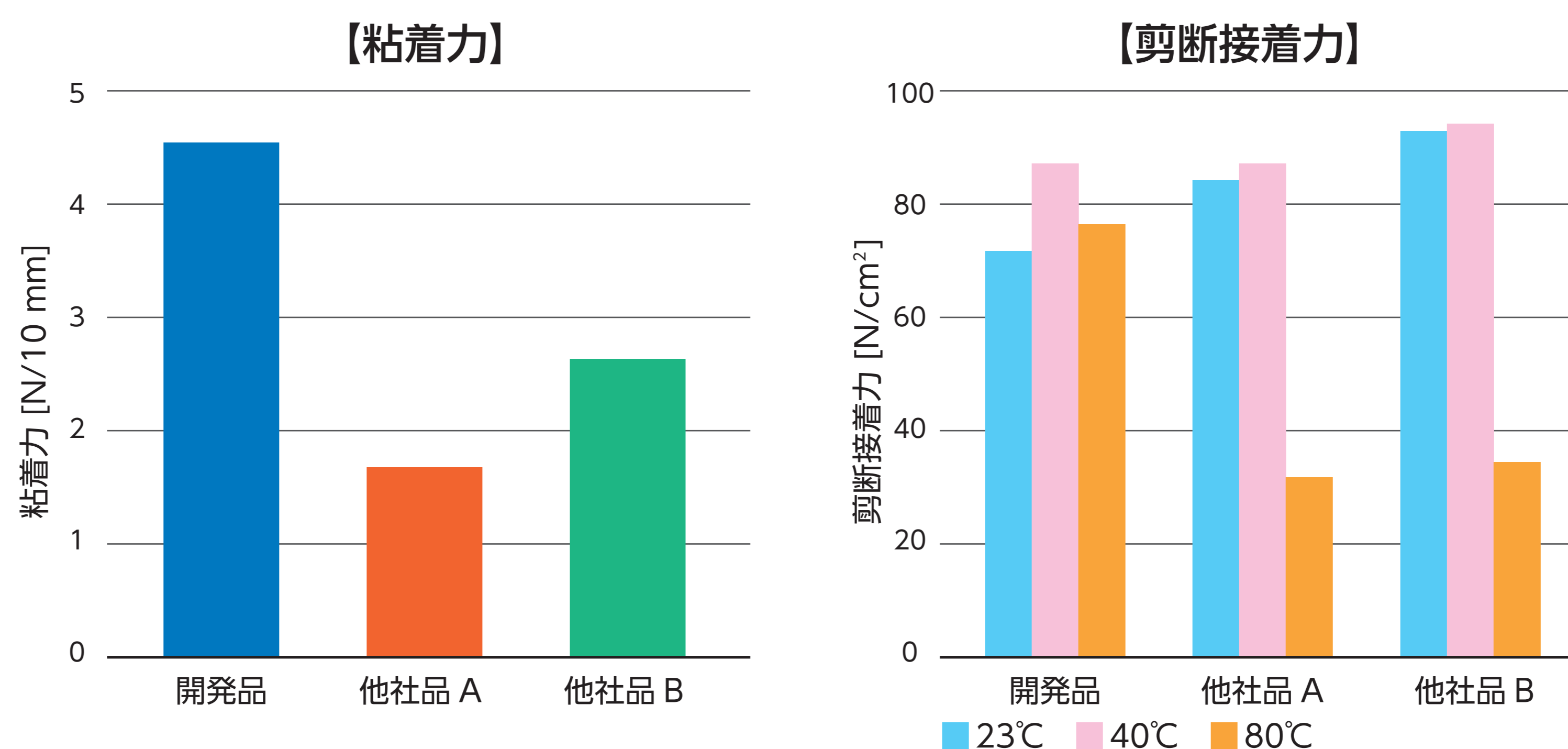


## 特長

- 非常に薄い両面粘着テープですが、強粘着で、芯材が柔軟かつ強靱なため、変形した場合も追従し、浮き等が発生しづらくなっています
- 荷重が掛ってもずれにくく、保持性、耐熱性に優れています
- 高温（ $180^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$ ）で加熱しても変色が小さく白色板上でも目立ちません



## 基本物性



薄くても強粘着を示します

耐熱性に優れ、加熱しても高い接着性を示します

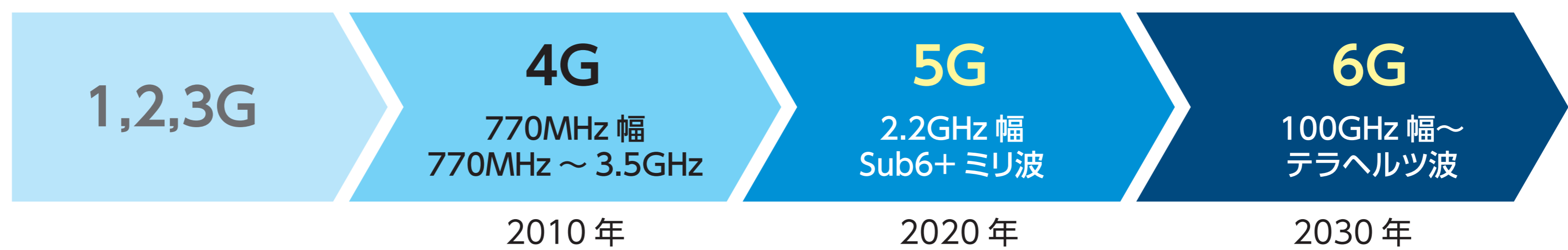
※各物性は代表値であり保証値ではありません

# 低誘電粘着剤

5G や6G といった次世代通信技術に対応した低誘電粘着剤です

## 低誘電について

移動通信システムの進化



課題

周波数

高

→ 伝送損失

大

低誘電材料

伝送損失の低減を可能に

## 用途

次世代高速通信部材の回路基板やアンテナなどに使用される粘着シートの粘着剤を想定しています

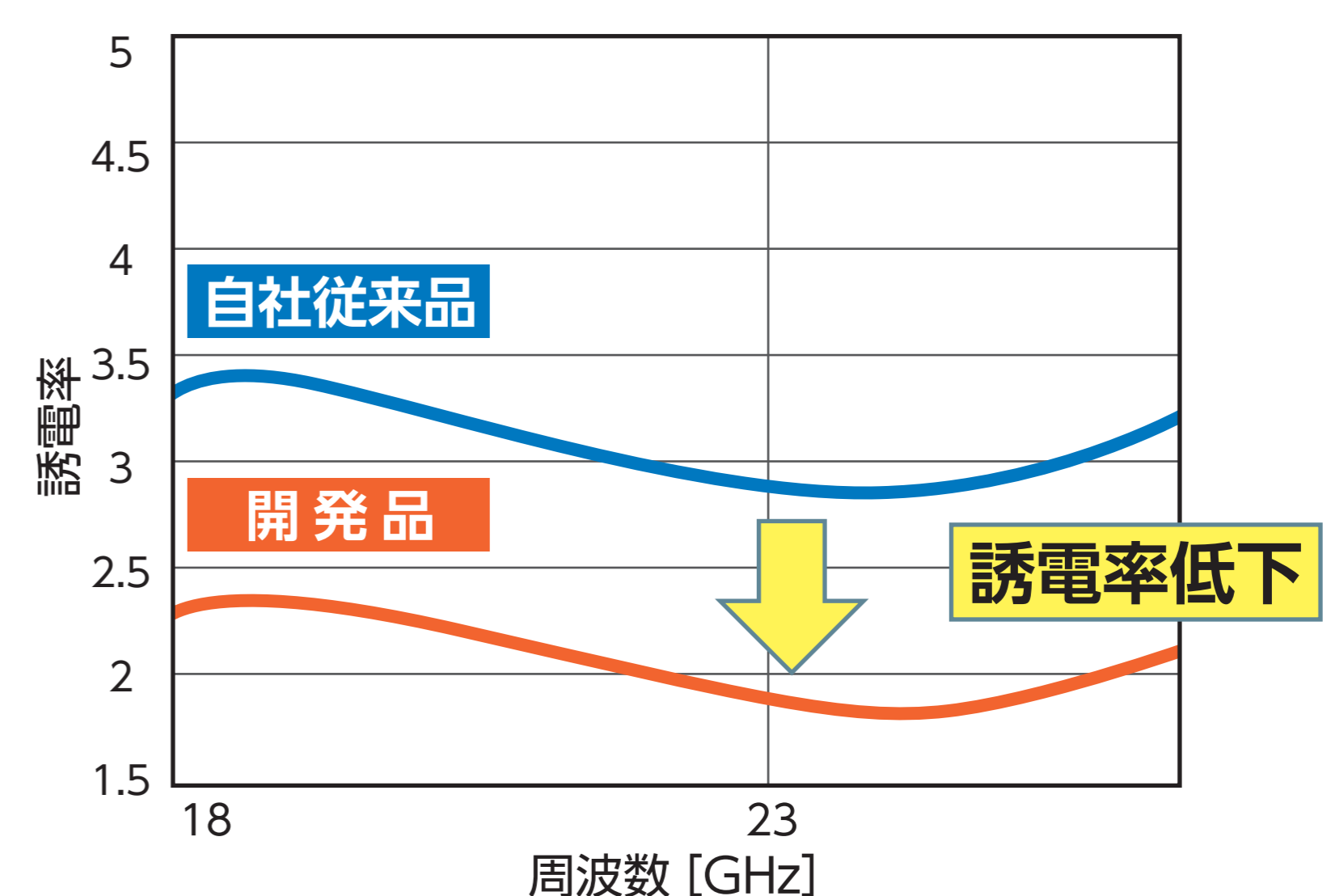
## 物性

自社従来品よりも誘電率の低い粘着剤です  
低誘電性と粘着性の両立が可能です

### 誘電特性

		開発品	自社従来品
誘電率	18GHz	2.3	3.5
	22GHz	2.0	3.0
	25GHz	1.9	2.9

測定方法：フリースペース法



### 粘着特性

サンプル構成



粘着力 [N/10mm]	2.3
保持力 [mm]	0
ボールタック [No.]	7

※構成：粘着物性測定にのみ使用  
※各物性は代表値であり保証値ではありません